## イオン液体分子線を用いた気-液界面での初期ガス溶解過程の研究

(大阪大学理学研究科<sup>1</sup>,立命館大学理工学部<sup>2</sup>)松浦 裕介<sup>1</sup>,寺本 高啓<sup>2</sup>,〇大山 浩<sup>1</sup> Study on initial gas dissolution dynamics at the gas-liquid interface by using an ionic liquid beam

(Graduate School of Science Osaka University<sup>1</sup>, Department of Electrical & Electronic Engineering, Ritsumeikan University<sup>2</sup>) Yusuke Matsuura<sup>1</sup>, Takahiro Teramoto<sup>2</sup>, ○Hiroshi Ohoyama<sup>1</sup>

[序] 気一液界面での動的過程(エネルギー移動・分子移動・反応)は、不均一系での基礎的か つ重要な多くの現象(例えば、溶解過程、蒸留過程さらには生物の呼吸・細胞膜の分子移動等) と深く関わっている。しかしながら、これら基礎的過程の衝突ダイナミクスに関する直接研究は ほとんどない。イオン液体への気体溶解に関しても、平衡状態のガス溶解度は、ヘンリーの法則 に従い、温度の上昇とともに低下することが知られている。今回、イオン液体等を液体フィルム 分子線として真空中に噴出し、これに CO<sub>2</sub>分子線を衝突させ、King and Well 法により溶解確率 を求め、そのイオン液体の液温依存性から初期溶解メカニズムについて考察した。気ー液界面の 溶解過程は、気体 ( $n_g$ ) ⇔界面 ( $n_s$ ) 吸着・脱離過程、界面 ( $n_s$ ) ⇔バルク ( $n_l$ ) 間の分子移動過 程よりなるが、本研究条件下では、バルクから界面への分子移動過程( $n_l \rightarrow n_s$ )は無視でき、溶解 初期過程のみを選択的に測定できるため、気一液界面に特有な溶解メカニズムが期待される。

[イオン液体分子線の開発] イオン液体フィルム分子線発生のため、図1に示す循環システムを 有するイオン液体フィルム分子線衝突実験装置を試作した。均一で薄い膜厚の液体フィルムの発 生を可能にするため、様々な形状のノズルチップを試作し、最適化した。イオン液体 [C4min][NTf2]に対して得られた液体フィルムの写真を図2に示す。約10mm幅のフィルム分子 線が形成されている事が分かる。また、分子線の衝突入射角を可変とするため、ノズルを回転可 能とした。さらにイオン液体の粘性が、液温に非常に敏感であるため、熱電対及び冷却水循環系 を組み合わせた制御システムを構築し、これにより安定した液体フィルムの発生を実現した。



図1イオン液体フィルム分子線衝突実験装置

図2イオン液体[C4min][NTf2]の フィルム分子線

[[C<sub>4</sub>min][NTf2]への CO<sub>2</sub>初期溶解過程] イオン液体[C<sub>4</sub>min][NTf2]フィルム分子線に、3 段差動 排気して $\phi$ 1mm にコリメートした CO<sub>2</sub>分子線を衝突させ、質量分析計(m/e=44) を用いて、King and Well 法により、初期溶解確率を求めた。法線方向から入射した場合の測定結果の例を図 3 に示す。ビームフラッグ (BF) を in-out することで、[C<sub>4</sub>min][NTf2]フィルム分子線への CO<sub>2</sub> 分子線衝突を変調すると溶解により信号強度が減少するのが分かる。また、各 BF in-out の間に、 ビームストップ (BS) を in-out して CO<sub>2</sub>分子線を変調し、バックグランド信号の長期変動の寄 与を取り除いた。溶解確率は、**S** = (I<sub>BF-in</sub> - I<sub>BF-out</sub>)/I<sub>BF-in</sub> で定義する。

図 4(A) に CO<sub>2</sub>分子線の法線入射条件下での溶解確率の液温依存性を示す。ヘンリーの法則に 反して、液温の上昇に伴い溶解確率が増加することから、界面吸着を経ない新たな溶解機構の存 在が期待できる。自由体積を経由した直接溶解の可能性を検証するため、自由体積が界面上で占 める面積の温度依存性を、イオン液体密度の温度変化から次式で評価した。

 $S(T) = \alpha(T) \times [V_{free}(T)/(V_0(T_0) + V_{free}(T))]^{2/3} = \alpha(T) \times (d_0/d_T - 1)^{2/3}$ しきい温度を To=281.15 K とすると、初期溶解確率と自由体積に良い相関が得られた(図4赤線)。

一方 [C<sub>4</sub>min][NTf2]への CO<sub>2</sub>会合構造の量子化学計算(図 5)から、CO<sub>2</sub>溶解が可能な[NTf2]— CO<sub>2</sub>間距離(r)は r > 5Å に制限されることが分かった、この結果と、Fürth モデルによる自由体積 サイズ分布の温度依存性の評価から、初期溶解過程でのしきい温度の存在や反ヘンリーの法則的 な液温依存性が定量的に説明できることが分かった。これらの結果は、イオン液体の熱運動に伴 い生じる自由体積を経由したバルク層への直接溶解機構( $n_g \rightarrow n_1$ )を強く支持するものである。 CO<sub>2</sub>以外の気体の結果も含め、詳細については当日発表する。



図 3 [C<sub>4</sub>min][NTf2]への CO<sub>2</sub>溶解過程の King and Well 法による測定例



図 5 [C<sub>4</sub>min][NTf2]への CO<sub>2</sub>会合 構造と自由体積サイズの関係



図 4 (A)イオン液体[C<sub>4</sub>min][NTf2] フィルム分子線への CO<sub>2</sub> 初期溶解 確率の液温依存性と自由体積との 相関、(B)α(T)のしきい温度依存性